

中信建投证券股份有限公司
关于合肥顾中科技股份有限公司
2024 年持续督导年度报告书

保荐人名称：中信建投证券股份有限公司	上市公司名称：合肥顾中科技股份有限公司
保荐代表人姓名：吴建航	联系方式：021-68801584 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号北塔 2203 室
保荐代表人姓名：廖小龙	联系方式：021-68801584 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号北塔 2203 室

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）“证监许可（2023）415 号文”批准，合肥顾中科技股份有限公司（简称“公司”或“顾中科技”）向社会公开发行人民币普通股 200,000,000 股。公司本次发行新股的发行价为 12.10 元/股，募集资金总额人民币 2,420,000,000.00 元，扣除发行费用合计人民币 187,373,816.76 元后，募集资金净额人民币 2,232,626,183.24 元。本次公开发行股票于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）担任本次公开发行股票保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由中信建投证券完成持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》，中信建投证券出具本持续督导年度报告书。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐人已建立健全并有效执行了持续督导工作制度，并结合持续督导各项工作事宜制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	保荐人已与顾中科技签订《持续督导协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务。
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	保荐人通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查、查阅相关公开信息进行尽职调查等方式，了解顾中科技经营、股票交易等情况，对顾中科技开展持续督导工作。经核查，本持续督导期内，上市公司不存在持续经营能力、核心竞

序号	工作内容	持续督导情况
		争力或者控制权稳定有重大不利影响的风险或者负面事项。
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	保荐人通过现场检查、现场培训等措施，督导公司遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件。经核查，本持续督导期内，顾中科技未出现按有关规定须保荐人公开发表声明的违法违规情况。
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	保荐人取得了上市公司及相关当事人的各项承诺，逐一核查承诺履行情况。经核查，本持续督导期内，顾中科技及相关当事人未发生违法违规或违背承诺等事项。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	保荐人通过现场检查、现场培训等措施，督导顾中科技及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺。经核查，本持续督导期内，顾中科技及其董事、监事、高级管理人员均遵守相关法律法规及规范性文件，不存在违反承诺的情形。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	保荐人督促顾中科技依照相关规定健全完善公司治理制度并严格执行，取得了各项制度，并对重大投资、关联交易等事项进行了核查。经核查，本持续督导期内，公司已建立健全并有效执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐人对顾中科技的内部控制制度的设计、实施和有效性进行了核查，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等，并了解其内部审计的执行情况。经核查，本持续督导期内，顾中科技的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行。
9	督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐人督促顾中科技严格执行信息披露制度，同时及时审阅信息披露文件及其他相关文件。经核查，本持续督导期内，公司已建立健全并有效执行信息披露制度，不存在信息披露更正或补充公告的情况，不存在向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。

序号	工作内容	持续督导情况
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。 对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	保荐人对顾中科技的信息披露文件及其他相关文件进行了及时事前审阅，并查阅了相关公开信息及对相关主体进行访谈。经核查，本持续督导期内，公司不存在相关文件存在问题需进行信息披露更正或补充公告的情况，不存在不予更正或补充应及时向上海证券交易所报告的情况。
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	保荐人督促顾中科技完善并严格执行内部控制制度，并通过现场检查、现场培训等措施，督导顾中科技及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件。经核查，本持续督导期内，顾中科技及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	保荐人取得上市公司及控股股东、实际控制人的各项承诺，逐一核查承诺履行情况，并查阅相关公开信息，访谈相关主体。经核查，本持续督导期内，顾中科技及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况。
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	保荐人查阅了公司公告与相关公开信息，并对相关主体进行访谈。经核查，本持续督导期内，顾中科技不存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的重大事项。
14	发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	保荐人通过现场检查、现场培训等措施，督导顾中科技及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件。经核查，本持续督导期内，顾中科技未发生相关情况。

序号	工作内容	持续督导情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往来或者现金流存在重大异常；（六）上海证券交易所要求的其他情形。	本持续督导期内，保荐人已针对上市公司制定了严格的现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。经核查，本持续督导期内，保荐人已按相关要求对上市公司开展了定期现场检查。
16	持续关注上市公司的承诺履行情况。	保荐人取得了上市公司及相关当事人的各项承诺，并持续关注相关承诺履行情况。经核查，本持续督导期内，公司上市公司及相关当事人未发生违反承诺履行的情况。

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现顾中科技存在重大问题。

三、重大风险事项

在本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

（一）核心竞争力风险

1、技术及产品升级迭代的风险

随着全球集成电路行业的不断发展及终端应用产品对集成电路相关性能的要求不断提高，集成电路对端口密度、信号延迟及封装体积等提出了越来越高的要求。以显示驱动芯片为例，一方面，显示屏幕分辨率、清晰度的提升意味着更多 I/O 数量，对凸块制造的密度、间距提出越来越高的要求，测试的复杂性也随之提升，后段封装的精准度和难度也大幅增加；另一方面，AMOLED、Mini Led、Micro Led 等新型显示技术正处于发展阶段，相关新型显示技术对已有显示技术的升级迭代将间接对显示驱动芯片封测技术产生一定影响。

如果公司无法根据行业发展趋势和下游客户需求进行技术与产品创新，或新开发的产品质量未能得到客户认可，或研发项目无法顺利实现商业化，将可能面临订单流失、市场地位下降的风险，从而对公司的核心竞争力造成不利影响。

2、研发技术人才流失风险

集成电路封测行业是典型的技术密集行业，企业的技术研发实力源于对专业人才的储备和培养。虽然近几年中国大陆集成电路封测行业取得快速发展，从业人员逐步增多，但专业研发人才供不应求的情况依然普遍存在。由于近几年市场对于集成电路封测高端人才的需求急剧增加，人才聘用成本不断上升，未来一段时间，专业人才相对缺乏仍将成为制约行业发展的重要因素之一。若公司核心技术人才流失，将对公司的研发生产造成不利影响。

（二）经营风险

1、毛利率波动的风险

报告期内，公司主营业务毛利率 31.16%，较去年同期略有下滑，公司显示驱动芯片、非显示类芯片封测业务下游应用领域主要为高清电视、智能手机、笔记本电脑等，对宏观经济形势较为敏感。如果未来宏观经济形势发生变化，下游应用领域发展不达预期，行业规模增速放缓或出现下滑，可能对公司产品市场需求、销售价格产生负面影响，进而导致公司毛利率下滑，影响公司的盈利能力及业绩表现。

2、非显示类业务开拓不利的风险

公司从 2015 年开始布局铜镍金凸块、铜柱凸块、锡凸块等非显示先进封装技术的研发，并于 2019 年完成后段 DPS 封装的建置，目前正在建置正面金属化工艺（FSM）&晶圆减薄-背面研磨/背面金属化（BGBM）的制程，公司非显示类业务虽增长较快但整体规模相对较小，非全制程占比较高，且主要集中在电源管理、射频前端等芯片领域，客户主要集中在中国境内，与长电科技、通富微电、华天科技等头部综合类封测企业相比综合实力具有较大差距。若综合类封测企业对相关细分领域进行大规模投入、非显示类客户导入不及预期或下游终端市场环境出现不利变化等情况，则存在非显示封测业务开拓不利的风险。

（三）财务风险

1、汇率波动风险

公司存在部分境外销售及境外采购的情况，并主要通过美元或日元进行结算。

未来若人民币与美元或美元与日元汇率发生大幅波动,可能导致公司产生较大的汇兑损益,引起公司利润水平的波动,对公司未来的经营业绩稳定造成不利影响。

2、存货跌价风险

报告期,公司存货账面价值为 46,847.41 万元,占期末资产总额的比重为 6.70%。公司期末存货金额较大,占比较高,并且公司存货金额可能随着公司业务规模扩大进一步增长。如果未来市场需求、价格发生不利变动,公司将面临存货跌价的风险,进而会给公司经营造成一定的不利影响。

3、商誉减值风险

2018 年 1 月,公司收购苏州顾中形成商誉 88,748.48 万元。报告期内,苏州顾中系公司封装测试业务主要经营主体,如果未来封装测试市场需求、产业政策或其他不可抗力等外部因素发生重大不利变化,而苏州顾中未能适应前述变化,则可能对苏州顾中的盈利能力产生不利影响,进而可能使公司面临商誉减值的风险,从而对公司经营业绩产生不利影响。

4、税收优惠存在不确定性的风险

报告期内,公司子公司苏州顾中享受高新技术企业 15%的所得税优惠税率,若未来上述税收优惠政策发生变化或者子公司苏州顾中不再符合税收优惠条件,则可能对公司的经营业绩和盈利产生不利影响。

5、政府补助政策变化风险

报告期内,公司计入当期损益的政府补助金额为 5,776.75 万元。集成电路行业系国家重点战略产业,目前各级政府或主管部门给予的补助政策较多,如果未来政府部门对公司所处产业的政策支持力度有所减弱,或者其他补助政策发生不利变化,公司取得的政府补助金额将会有所减少,进而对公司的经营业绩产生一定的影响。

(四) 行业风险

1、市场竞争加剧的风险

近年来,各大封测厂商积极布局先进封装业务,在显示驱动芯片封测领域,

除细分行业龙头颀邦科技、南茂科技继续在相关领域保持领先地位外，综合类封测企业通过自建（如通富微电）或与其他方合作（如日月光与同兴达）等方式对相关领域也进行积极布局。相较于行业内头部封测企业，公司在资产规模、资本实力、产品服务范围等方面存在一定差距，面对行业竞争加剧的局面，若公司不能较好地采取措施应对，可能会对公司业务开拓以及经营业绩产生不利影响。

2、行业波动及需求变化风险

近年，全球半导体市场面临的激烈竞争以及地缘政治等不确定因素的影响，对集成电路行业的盈利空间造成了一定程度的冲击。公司主营业务为集成电路封测综合服务，覆盖显示驱动芯片、电源管理芯片、射频前端芯片等多类产品，集成电路行业的发展状况对公司的生产经营具有重大直接影响。集成电路行业具有与宏观经济同步的特征，其波动幅度甚至会超过全球经济波动幅度。若未来宏观经济形势变化，全球集成电路产业市场出现较大波动，将对公司经营业绩带来一定的影响。

3、产业政策变化的风险

公司所处的集成电路行业是国家重点鼓励发展的领域之一。国家陆续出台了包括《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》、《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》等多项产业政策，促进集成电路行业发展；在财税、投融资、研究开发、人才、知识产权、进出口等方面给予一系列优惠措施，以推动集成电路行业的健康发展，如未来上述产业政策出现不利变化，将对公司的业务产生一定不利影响。

（五）宏观环境风险

目前，国际贸易摩擦不断，全球半导体市场面临较大压力，半导体产业仍处于周期性波动中，公司主营业务为集成电路封装测试服务，具有较强的周期性。例如，下游显示面板行业具有周期性较强、价格波动较大的特点，间接对显示驱动芯片及相关封测需求产生较大影响。同时，显示驱动芯片、电源管理芯片以及射频前端芯片等产品的下游终端主要为消费类电子，如智能手机、平板电脑、笔记本电脑、高清电视、智能穿戴等，相关产品性能更新速度快、品牌及规格型号繁多使得需求变化较大，存在不确定性。未来，若全球经济增幅放缓，可能导致

消费者消费不如预期，进而持续影响半导体行业，对公司生产经营产生不利的影响。

四、重大违规事项

在本持续督导期间，顾中科技不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2024 年，公司主要财务数据如下所示：

单位：元			
主要会计数据	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	1,959,375,628.33	1,629,340,035.50	20.26
归属于上市公司股东的净利润	313,276,970.57	371,662,508.64	-15.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	276,676,779.67	339,685,424.03	-18.55
经营活动产生的现金流量净额	690,346,690.70	541,275,168.61	27.54
主要会计数据	2024 年末	2023 年末	本期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	6,003,292,022.20	5,830,126,768.94	2.97
总资产	6,991,013,658.68	7,153,333,609.63	-2.27

公司主要财务指标如下表所示：

主要财务指标	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益（元/股）	0.26	0.33	-21.21
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.33	-21.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.23	0.30	-23.33
加权平均净资产收益率（%）	5.29	7.59	减少 2.30 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.67	6.93	减少 2.26 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	7.89	6.52	增加 1.37 个百分点

2024 年，公司主要财务数据及指标变动的原因如下：

1、报告期内，营业收入同比上升 20.26%，主要系市场行情回温，客户订单量增加所致。

2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比下降 15.71%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 18.55%，主要系募投项目建设导致固定资产折旧及人工费用上涨，实施限制性股票激励计划导致股份支付费用较上年同期大幅增长所致。

3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比上升 27.54%，主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

4、报告期基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降，主要系本期净利润下降所致。

5、报告期加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比下降，主要系本期净利润下降所致。

6、报告期研发投入占营业收入的比例同比上升，主要系公司持续加大研发投入，提升核心技术，丰富产品结构所致。

六、核心竞争力的变化情况

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

（一）技术研发优势

集成电路先进封装测试属于技术密集型行业，技术研发能力是企业赖以生存的基础。自设立以来，公司即定位于以凸块制造（Bumping）和覆晶封装（FC）为核心的先进封装企业。在显示驱动芯片封测领域，凭借多年来的研发积累和技术攻关，公司掌握了“微细间距金凸块高可靠性制造技术”、“高精度高密度内引脚接合技术”、“测试核心配件设计技术”、“薄膜覆晶封装高效散热技术”等一系列具有自主知识产权的核心技术，覆盖了凸块制造、晶圆测试和后段封装测试等全部工艺流程。相关技术可在约 30 平方毫米的单颗芯片上最多“生长”出四千余金凸块，并可确保芯片引脚与凸块之间高精度、高准确性地结合。同时，公司具备双面铜结构、多芯片结合等先进 COF 封装工艺，并在业内前瞻性地研发了“125mm 大版面覆晶封装技术”，可以成倍增加所封装芯片的引脚数量，适用于

高端智能手机 AMOLED 屏幕。目前，公司已具备业内最先进 28nm 制程显示驱动芯片的封测量产能力，相关技术为高端芯片性能的实现提供了重要保障。

此外，公司将凸块技术延伸至电源管理芯片、射频前端芯片等非显示类芯片封测领域。公司围绕铜镍金凸块、铜柱凸块、锡凸块等领域开发出“低应力凸块下金属层技术”、“微间距线圈环绕凸块制造技术”、“高厚度光阻涂布技术”、“真空落球技术”、“高精密覆晶方形扁平无引脚及模块之封测的技术”等多项核心技术。具体而言，作为大陆地区少数实现铜镍金凸块量产的企业，公司可通过多层金属与介电材质的堆叠，在不改变芯片内部结构的情况下，优化后段封装形式，大幅提升芯片产品性能；在铜柱凸块、锡凸块技术上，公司也实现了较多的技术积累，实现了从凸块制造到后段封装的全制程扇入型晶圆级芯片尺寸封装（Fan-in WLCSP）技术，并已成功导入客户实现量产。该技术可实现封装后芯片尺寸基本等同于封装前尺寸，并降低封装成本，是未来先进封装的主流形式之一。同时面对“后摩尔时代”芯片尺寸越来越小、电性能要求越来越高的技术发展趋势，公司建立了 DPS 和载板覆晶封装制程，助力实现更小尺寸和更高集成度的整套封装测试的解决方案。针对功率器件及集成电路（Power IC）散热及封装趋势，建置正面金属化工艺（FSM）& 晶圆减薄-背面研磨/背面金属化（BGBM）的制程，可加大对集成电路（Power IC）及功率器件的市场覆盖。如此提升全制程封测能力，进一步降低生产成本。

（二）高质量、高稳定性和高可靠性的产品优势

公司高度重视品质问题，公司将风险思维及过程管理模式贯穿于研发、制造、检测的全流程，通过产品质量先期策划及生产件批准流程，严格把控产品质量形成的各阶段，以确保每一件产品都能达到最高标准，满足客户的需求。同时，公司一直致力于建立健全质量控制体系，通过了包括 IATF16949 汽车行业质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO9001 质量管理体系、ISO45001 职业健康与安全管理、ANSI/ESD S20.20 静电防护管理体系认证等为代表的一系列国际体系认证，并在内部建立了全方位、多层次和极其严苛的质量管理标准，有效地保证了产品的优质、稳定。

报告期内，公司在凸块制造、COG/COP、COF、DPS 等各主要生产环节的生产

良率可稳定在 99.95%以上。优异的品质管控能力为公司树立了良好口碑，也为公司业务开展奠定了坚实基础。

（三）技术改造与软硬件开发优势

集成电路的先进封装与测试领域涉及的工序较多且技术发展日新月异，需要对生产软硬件进行不断地升级改造以快速响应客户需求。公司一直致力于智能制造的投入与专业人才的培养，拥有一支 20 余人的专业化团队，具备较强的核心设备改造、配件设计以及自动化系统开发能力。

在核心设备改造方面，公司自主设计并改造了一系列适用于 125mm 大版面覆晶封装的相关设备，为大版面覆晶封装产品的量产奠定了坚实基础，并自行完成了核心 8 吋 COF 设备的技术改造以用于 12 吋产品，大幅节约了新设备购置所需的时间和成本；在高端设备配件及工治具设计方面，公司研发设计出高温测试治具装置，解决了测试温度均匀性问题，提升了晶圆测试效率和品质；在系统开发方面，自主研发出真空溅镀、电镀等关键节点参数智能化监控系统，并且开发出测试自动化体系，进一步提升了公司整体的工艺管控水平。出众的技术改造与软硬件开发能力是公司自主创新的重要体现。

（四）丰富的产品组合及特色工艺优势

公司可顺应客户要求，提供基于 8 吋、12 吋晶圆的全制程“一站式”封测业务，可极大提高产品的稳定性与可靠性，并有效减轻客户成本。针对电源管理芯片、射频前端芯片等产品对于高 I/O 数、高电性能、低导通电阻日益增长的需求，公司可提供如铜镍金凸块、铜柱凸块、锡凸块等先进凸块制造技术以及重布线、多层堆叠等特色工艺，也可提供全制程的 Fan-in WLCSP 量产服务以满足客户需求。此外，公司还可为客户提供各类配套服务，如凸块制造所需的光罩设计、探针卡的设计维修、薄膜覆晶卷带设计、测试程式开发等。丰富的产品组合和先进的特色工艺为公司提供了极具市场竞争力的业务基础。

（五）地域优势

公司客户主要为集成电路芯片设计企业，其对交货时间要求严格，交货时间短和便利的地理位置可为集成电路芯片设计企业减少库存，节约运输时间和资金

成本,及时应对来自客户的随机性和突发性需求,方便企业与客户交流和反馈,增强其竞争力。

公司注册地合肥市近年来在集成电路领域形成了一定的规模效应,目前已成为中国大陆集成电路产业发展最快、成效最显著的城市之一。合肥市被国家发改委和工信部列为集成电路产业重点发展城市,也是全国首个“海峡两岸集成电路产业合作试验区”和首批“国家集成电路战略性新兴产业集群”。

合肥市具有良好的产业基础和经营环境,政府大力推进集成电路产业的集群发展,据不完全统计,合肥已聚集集成电路企业超 400 家,从业人员超 2.6 万人,构建了从设计、制造、封装测试、装备材料,到公共服务平台的完整产业链生态。晶合集成、京东方、维信诺等与公司相关的上下游企业均在合肥有所布局。

长三角地区是目前中国大陆集成电路产业的主要集群区域,已形成了芯片研发、设计、制造、封装测试以及相关物料和设备等较完整的集成电路产业链。江苏集成电路产业链完备、配套能力强,芯片设计与制造能力提升较快。全资子公司苏州硕中所在的苏州工业园区也汇集了和舰芯片、华星光电等公司上下游企业。

此外,公司在中国台湾设有办事处,可与当地 IC 设计客户保持更为紧密的沟通,有助于公司境外业务的开展。优越的地理位置为公司发展提供了丰沃土壤,有利于公司减少交货时间并节约运输时间、库存成本,同时有助于公司及时处理客户或下游企业的各类需求,方便与其直接交流和反馈,公司在成本控制、人才资源、专业技术上的优势将越发突出。

(六) 团队经验丰富、具有创新精神的管理团队

公司的经营管理团队主要来自内部培养,具有较高的人员稳定性,同时主要成员在集成电路先进封测行业拥有超过 15 年以上的技术研发和生产管理经验,具备国际一流先进封测企业的视野和产业背景。自设立以来,公司经营管理团队通过技术引进、消化吸收和自主创新,逐步积累和提高了以凸块制造(Bumping)和覆晶封装(FC)为代表的先进封装技术及生产管理能力。在管理团队的卓越带领之下,公司业务规模不断增长,行业地位显著提升。经验丰富且稳定的管理团队,有利于公司继续保持在行业内的领先地位,不断提升公司品牌效应。

（七）优质的客户资源和市场开发优势

凭借领先的先进封测能力、高品质的产品质量以及多品种的封测服务种类，公司赢得了境内外集成电路设计企业的广泛认可，并与众多国内外知名设计公司保持了良好且稳定的合作关系。在显示驱动芯片封测领域，公司积累了联咏科技、敦泰电子、奇景光电、瑞鼎科技、谱瑞科技、晶门科技、集创北方、奕斯伟计算、云英谷、格科微、通锐微等境内外知名的客户；在非显示类芯片封测领域，公司开发了昂瑞微、矽力杰、杰华特、南芯半导体、纳芯微、艾为电子、唯捷创芯、希荻微等优质客户资源。上述客户在集成电路相关领域具有较高的市场占有率和知名度。此外，公司拥有一支在集成电路上下游产业链具有丰富经验和人脉资源的业务团队，有利于公司更好地开拓和服务好客户。优质客户的深度及广度是公司重要的竞争优势。

七、研发支出变化及研发进展

为了保证公司能够不断进行技术创新，保持产品和服务的技术领先水平，维持公司的市场竞争优势，公司持续进行研发投入。报告期内，公司研发投入15,468.66万元，较上年同期增长45.53%。截至报告期末，公司研发人员数量增至284人，较上年同期增长26.22%，研发人员数量占公司比例为12.96%。

2024年，公司获得授权发明专利11项（中国7项，国际4项）、授权实用新型专利10项，软件著作权1项，包括晶圆表面介电层的制备方法、晶圆结构及凸块的成型方法、一种电镀导电治具、一种用于芯片散热贴的取标头、散热粘贴装置及粘贴方法、覆晶封装结构的形成方法、覆晶封装结构及显示装置、用于去除卷带芯片的芯片剔除装置、适于高粘度光阻的缓冲装置与光阻供液系统、可挠性线路板、薄膜覆晶封装结构及显示装置、散热贴贴附方法、封装方法、封装构型及贴附装置、用于芯片封装的顶针装置、芯片重布线结构及其制备方法等在内的授权专利均为自主研发，且上述技术大部分已在公司产品上实现了应用。截至报告期末，公司累计获得127项授权专利，其中发明专利60项（中国53项，国际7项）、实用新型专利66项、外观设计专利1项。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 21,228.86 万元，具体使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	242,000.00
减：支付发行有关费用	18,737.38
首次公开发行募集资金净额	223,262.62
减：使用募集资金金额	205,183.52
其中：以自筹资金预先投入募投项目的置换金额	24,873.31
直接投入募投项目金额	166,510.21
使用超募资金永久补充流动资金金额	13,800.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	3,149.76
减：补流资金利息收入扣除手续费净额转出	0.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专项账户应结余额	21,228.86
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额	21,228.86
差异金额	0.00

报告期内，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 6,900.00 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.66%。截至 2024 年 12 月 31 日，该部分金额已经从募集资金专户中转出并使用。本报告期内，公司不存在高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助的情况。

2024 年 8 月 14 日，公司召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司将“顾中先进封装测试生产基地项目”达到预定可使用状态的日期调整为 2024 年 12 月，截至 2024 年 12 月 31 日，该项目已结项。

2024 年 8 月 14 日，公司召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况并

经相关审批后，使用自有外汇支付部分募集资金项目所需资金，再以募集资金等额进行置换。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司“硕中科技（苏州）有限公司高密度微尺寸凸块封装及测试技术改造项目”已达到预定可使用状态，募投项目结项，募集资金账户余额 1,037.46 万元，其中待支付给供应商金额 353.94 万元，预计节余资金 683.52 万元，计划用于永久补充流动资金。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司“硕中先进封装测试生产基地项目”已达到预定可使用状态，募投项目结项，募集资金账户余额 9,250.70 万元，其中待支付给供应商金额 6,568.51 万元，预计节余资金 2,682.19 万元，计划用于永久补充流动资金。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司“硕中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目”已达到预定可使用状态，募投项目结项，募集资金账户余额 950.40 万元，其中待支付给供应商金额 888.02 万元，预计节余资金 62.38 万元，计划用于永久补充流动资金。

公司 2024 年募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

1、实际控制人

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、控股股东

截至 2024 年 12 月 31 日，公司控股股东合肥硕中科技控股有限公司持有公司 397,127,159 股，持股比例为 33.40%。

3、董事、监事和高级管理人员

截至 2024 年 12 月 31 日，公司董事、监事和高级管理人员的持股情况如下：

序号	名称	任职	持股数量(万股)	持股比例
1	陈小蓓	董事长	-	-
2	余卫珍	董事（已换届）	-	-
3	赵章华	董事	-	-
4	罗世蔚	董事	7.90	0.0066%
5	许靖	董事（已换届）	-	-
6	黄玲	董事		
7	杨宗铭	董事、总经理	305.06	0.26%
8	余成强	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	251.24	0.21%
9	胡晓林	独立董事	-	-
10	崔也光	独立董事	-	-
11	王新	独立董事	-	-
12	左长云	监事会主席（已辞职）	-	-
13	杨国庆	监事会主席	-	-
14	吴茜	监事		
15	胡雪妹	职工代表监事（已换届）	-	-
16	朱雪君	职工代表监事		
17	朱晓玲	副总经理	-	-
18	周小青	副总经理	135.17	0.11%
19	李良松	副总经理（已辞职）	101.37	0.09%
20	张玲玲	副总经理	38.84	0.03%

注 1：公司监事及监事会主席左长云因个人原因于 2024 年 1 月申请辞去监事及监事会主席职务。2024 年 2 月，公司 2024 年第一次临时股东大会同意选举吴茜为第一届监事会非职工代表监事；公司监事会同意选举杨国庆为公司第一届监事会主席。公司副总经理李良松因个人原因于 2024 年 5 月申请辞去副总经理职务。2024 年 10 月，公司职工代表大会同意选举朱雪君为公司第二届监事会职工代表监事。2024 年 11 月，公司 2024 年第二次临时股东大会同意选举陈小蓓、赵章华、罗世蔚、黄玲、杨宗铭、余成强为第二届董事会非独立董事；同意选举胡晓林、崔也光、王新为第二届董事会独立董事；同意选举杨国庆、吴茜为第二届监事会非职工代表监事；公司董事会同意选举陈小蓓女士为公司第二届董事会董事长；公司监事会同意选举杨国庆女士为公司第二届监事会主席。

注 2：本表中列示的董事、监事和高级管理人员的持股情况不含通过中信建投基金-硕中科

技员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有的公司股份。

除上述持有公司股份外，公司董事、监事和高级管理人员均未以其它方式直接或间接持有公司股份。

（二）质押、冻结及减持情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人和董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐人认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导年度报告书出具之日，不存在保荐人认为应当发表意见的其他事项。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于合肥硕中科技股份有限公司
2024 年持续督导年度报告书》之签字盖章页）

保荐代表人签名： 吴建航

吴建航

廖小龙

廖小龙

